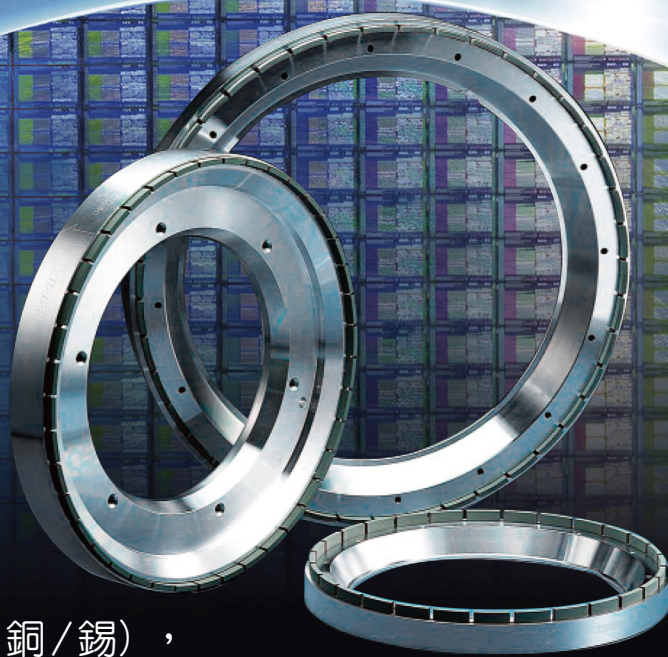




晶圓研磨砂輪

Wafer Grinding Wheels

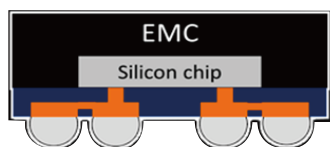


用於異質封裝（化合物／銅／錫），
碳化矽、氮化鎵、石英玻璃、矽及再生晶圓
等高效率減薄研磨加工。

特色

- 晶圓研磨砂輪可依客戶的晶圓減薄研磨加工需求，來客製化設計陶瓷結合劑、鑽石磨料及微結構組織，達到穩定的高效材料移除率，低磨耗長效使用壽命及低研磨阻抗電流等之高研磨效率及品質。

用途



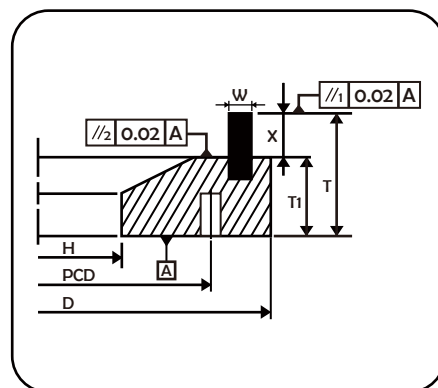
晶圓材質	砂輪規格
化合物 (EMC) 化合物+矽片 化合物 + 銅通孔，錫	Z1 #800~#2000 Z2 #3000~#5000
矽、碳化矽、氮化鎵、 石英玻璃	Z1 #325~#1500/2000 Z2 #2000~#8000/30000

● 砂輪種類

結合劑	製程應用		粒度										
			#325	#400	#600	#800	#1200	#1500	#2000	#4000	#6000	#8000	#30000
VW (瓷質法)	Z1	粗磨	●	●	●	●	●	●	●				
	Z2	細磨							●	●	●	●	●
BH (瓷質法)	Z1	粗磨	●	●	●	●	●	●	●				
	Z2	細磨							●	●			
BW (樹脂法)	Z1	粗磨	●	●	●								
	Z2	細磨				●	●	●	●	●			

● 砂輪尺寸

適合應用的設備		D,外徑 (mm)	T,厚度 (mm)	H,孔徑 (mm)	W,寬度 (mm)	X,高度 (mm)
Type-D	8"	208.7	22.5	158.0	2.5~5	5~10
	12"	312.0	30.0	237.0		
Type-T	10"	254.0	30.0	190.0		
	12"	304.0	30.0	240.0		
Type-O	10"	254.0	33.0	155.0		
	12"	304.0	35.0	190.0		
Type-S	10"	255.0	33.0	155.0		



● 研磨性能：異質封裝晶圓

晶圓		KINIK	競牌
		異質封裝晶圓	
砂輪規格	Z1	#600VW	#600
	Z2	#4000VW	#4000
研磨阻抗電流(A)		9~10	8~9
砂輪磨耗(um)		8~9	9~10
晶圓表面粗糙度(Ra,um)		0.025	0.026

● 研磨性能：矽、碳化矽晶圓

晶圓		8"矽晶圓	6"碳化矽晶圓	
砂輪規格	結合劑	VW	VW	
	鑽石粒度	#6000~8000	#2000	#8000
研磨阻抗電流(A)		7~9	~	15
砂輪磨耗(um)		0.5~2	0.4	~
晶圓表面粗糙度(Ra,um)		0.011	0.025	0.005